

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2026 年度计划向银行等具备资质的金融机构（以下简称“金融机构”）申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

上述申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。授信有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层代表公司负责办理综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日